

半導体用ドライエッチング剤 HFC-23(CHF3)

 TECHNICAL
DATASHEET

ドライエッチング剤 HFC-23(CHF3)は、半導体製造用の高純度エッチングガスです。

概要

- 半導体製造用のため純度は 99.999vol%(5N)以上です。
- 主に SiO₂, Low-k 膜のエッチング用途に適しています。

一般物性

項目	単位	数値
分子式	—	CHF3
分子量	—	70.01
沸点	℃	-82
蒸気圧(25℃)	MPa	4.729

【検査項目】

- 純分（エア分除く）、異種フロン、酸分、水分、エア分
- 個別の品質につきましては、お問い合わせ下さい。

用途

- エッチング

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。医療用途、食品用途などにお使いの場合は、当社まで事前にご連絡下さい。

梱包仕様

- 10L 容器、47L 容器 等

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-hfc-23-J_ver01_Aug_2019

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019